

Core-RK3506J 核心板规格书

版本：V1.0

修订历史

版本	日期	原因	修订者
V1.0	2025/5/12	创建文档	

目录

1. 注意事项	3
1.1 禁止事项	3
1.2 注意事项	3
2. 产品订购规格及订购信息	4
3. 产品简介	5
3.1. 核心板 RK3506 系列参数比较	5
3.2. 核心板接口硬件参数	6
4. 电气与性能参数	8
4.1. CPU 主频	8
4.2. 核心板主要配置	8
4.3. 环境参数	8
4.4. 电源电气参数	8
4.5. 功耗测试	8
4.6. IO 电气参数	9
5. 功能定义	9
5.1. 核心板接口定义	9
5.2. 引脚复用	14
6. 机械尺寸	15
6.1. 核心板机械尺寸	15
6.2. 核心板邮票孔接口封装	15
7. 技术支持	15
7.1. 基础技术支持	15
7.2. 增值技术支持	16
7.3. 技术支持联系方式	16
7.4. 定制服务	16
8. 售后服务	16
8.1. 保修条例	16
8.2. 维修周期	16
8.3. 维修费用	16
8.4. 运输费用	16
8.5. 送修地址	16

1. 注意事项

1.1 禁止事项

1. 注：在设计底板时“底板朝向核心板底的范围内不得摆放元器件”否则容易短路损毁！
2. 禁止带电插拔核心板及外围模块！
3. 禁止在没有静电防护的措施下直接操作本产品！
4. 禁止使用有机溶剂或者腐蚀性液体清洗本产品！
5. 禁止进行敲打，扭曲等可能造成物理损伤的操作！



1.2 注意事项

1. 操作前请注意对人体进行静电释放后，并佩戴静电手环。
2. 操作前请确认底板的供电电压和适配器电压在允许范围内。
3. 设计前请务必阅读本文档以及工程文件中的注意事项。
4. 注意产品在高温、高湿、高腐蚀环境下使用要进行散热、排水、密封等特殊处理。
5. 请勿自行维修、拆解，否则将无法享受免费的售后服务。

2. 产品订购规格及订购信息

系列	核心板型号	CPU	EMMC 容量	DDR 容量	温度等级
RK3506J	AC3506J-93M-SNLI	RK3506J	512MB	8GB	工业级

上述为我司Core-RK3506核心板命名信息，如需其它配置信息订购，请联系我司销售人员进行咨询。

3. 产品简介

RK3506J 集成了三核 ARM Cortex-A7 加单核 Cortex-M0，主频高达 1.5GHz。支持 AMP 多核异构架构，采用标准 RPMsg 核间通信机制。SDK 原生支持 LVGL 轻量级 UI 框架，并结合芯片内部 2D 硬件加速，让 LVGL 运行更加流畅，从硬件上电到引导程序加载及内核加载，最后到 UI 显示，全链路启动优化。

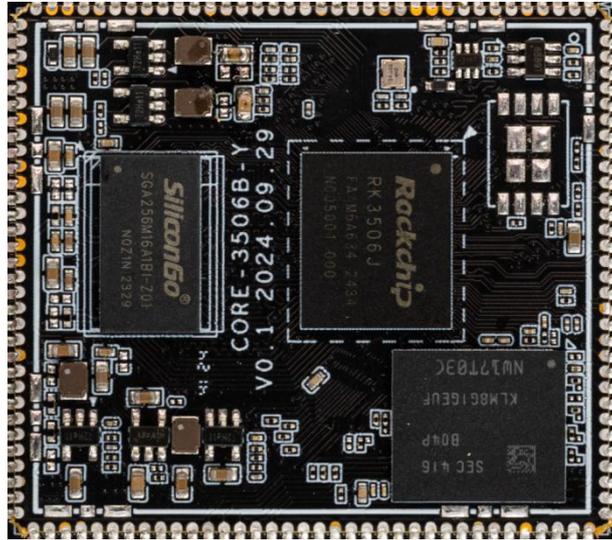
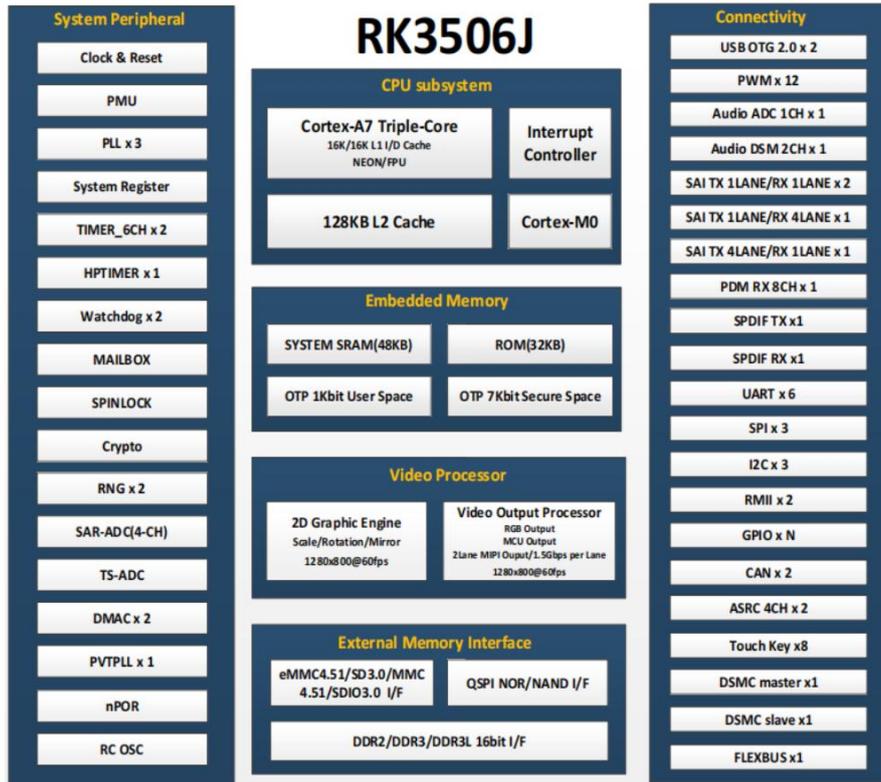


图 3.1 Core-RK3506J 核心板正面

3.1.核心板 RK3506 系列参数比较

表 3.1RK3506 系列选型

CPU 型号	系列	芯片核心差异	芯片封装	温度范围
RK3506J	RK3506J	工业级	11.3mm*13.3mm	-40~85℃
RK3506B	RK3506B	商业级	11.3mm*13.3mm	-20C~70℃



3.2.核心板接口硬件参数

Core-RK3506J 核心板将大部分引脚资源引出，部分引脚存在复用功能，设计时需考虑复用情况，硬件资源主要参数如表 3.2 所示：

表 3.2 Core-RK3506J 核心板关键参数表

Core-3506J(工业级)		
基本参数	SOC	Rockchip RK3506J
	CPU	四核 32 位处理器(3*Cortex-A7+1*Cortex-M0), 22nm 先进制程工艺, 正常模式主频最高 1.2GHZ, 超频模式主频最高 1.5GHZ
	图像处理	内置 2D 图解引擎
	视频解码	视频软解:720P@30fps、480P@60fps H264/MPEG, 支持 RTSP 视频流播放
	内存	512MB DDR3(256MB/512MB 可选)
	存储	8GB eMMC、256MB SPI Flash(可选)
	系统	Linux
	接口	邮票孔接口(136Pin, 1.2mm 间距)
	电源	5V(电压误差+5%)
	功耗	最大功耗:1.5W(5V/300mA) 典型功耗:1W(5V/200mA) 休眠功耗:0.2W(5V/40mA)
	尺寸	45.0mm x 40.2mm x 3.2mm
	重量	约 7g
	环境	工作温度:-40℃~85℃, 存储湿度:10%~90%RH(无凝露)
接口	网络	2 * RMI, 支持 10/100Mbps 数据传输速率

参数	视频输入	支持 DVP(Flexbus)
	视频输出	支持并行/串行 MCU/RGB LCD 接口:24 位(RGB888)、18 位(RGB666)、16 位(RGB565) 支持 BT.656/BT.1120 支持 MIPI-D5I(2Lanes, 1.5Gbps/lane), 最大输出分辨率:1280x1280@60fps
	音频接口	5 * SAI、1 * ADC、2 * DSM、1 * 12S/TDM(2ch)、1 * 12S/PCM(1ch)、1 * PDM RX(8ch)、1 * PDIF TX(8ch)、1 * SPDIF RX(8ch) 支持 3A:AEC(回声消除)、ANR(声抑制)、AGC(自动增益控制) 支持多 MIC 阵列处理:一般包括波束形成、盲源分离和声源定位 支持语音唤醒/检测:语音唤醒、关键词识别、声学事件检测、哭声检测、玻璃声碎和蜂鸣声检测
	USB	2xUSB2.0(OTG)
	SAL	5 * SAI: SAI0 支持 1 TX lane 和 4 RX lanes SAI1 支持 4 TX lanes 和 1 RX lane SAI2/3 支持 1 TX lane 和 1 RX lane SAI4 支持 1 RX lane 支持 I2S/TDM/PCM 模式, 支持最高采样率:192KHZ
	PWM	12 * PWM
	SPI	3 * SPI(支持串行主站和串行从模式, 软件可配置)
	I2C	3 * I2C(支持 7 位和 10 位地址模式, 标准模式下数据速率高达 100kbps, 快速模式下数据速率高达 400kbps, 快速模式 Plus 下数据速率高达 1Mbps)
	UART	6 * UART(内置 2 路 64 bitSFIFO, 可分别用 TX 和 RX;支持 5 位、6 位、7 位、8 位串行数据收发, 波特率高达 4Mbps;6 路 UART 均支持自动流控模式和 RS485 模式)
	CAN	2 * CAN FD
	DSMC	DSMC 双倍数据速率串行接口:最多支持选择 4 个芯片, 支持 8 线或 16 线串行传输模式
	Flexbus	1 * Flexbus(支持 1,2,4,8,16bit 数据并行传输, 时钟最高可到 100MHz)
	看门狗	外部看门狗
	其它接口	4 * SARADC、1 * SDMMC、93 * GPIO

备注: 部分引脚资源存在复用关系, 详细请参考引脚复用表。

4. 电气与性能参数

注：核心板支持系列其它型号兼容 CPU，同时支持其他容量的内存和 Flash 存储配置、温度级别以适用不同的场景。因此本章节的参数不代表某一具体的配置，是系列的参数。

4.1.CPU 主频

表 4.1 CPU 主频

项目	参数	规格				备注
		最小	典型	最大	单位	
Cortex-A7	Fclk	--	--	1.2GHz-1.6GHz	GHz	商业级
		--	--	1.2GHz-1.5GHz	GHz	工业级

4.2.核心板主要配置

表 4.2 配置参数

项目	规格				备注
	最小	典型	最大	单位	
DDR3	128	256	512	MB	可定制
eMMC	8	32	64	GB	可定制

4.3.环境参数

表 4.3 工作环境

项目	规格				备注
	最小	典型	最大	单位	
工作环境温度	0	--	70	℃	商业级
	-40		85		工业级
工作环境湿度	10%	--	90%	RH	无凝珠

4.4.电源电气参数

表 4.4 静态电气参数

项目	标号	规格				备注
		最小	典型	最大	单位	
系统电压	VCC4V0_ CORE	4.8	5.0	5.2	V	

4.5.功耗测试

表 4.5 功耗测试

工作状态	电压典型值	电流典型值	功耗典型值
状态一	5V	300mA	1.5W
状态二	5V	200mA	1.0W

4.6.IO 电气参数

表 4.6 GPIO 参数

项目		标号	规格			
			最小	典型	最大	单位
3.3V IO	高电平输入电压	VIH	2	--	VDDO+0.3	V
	低电平输入电压	VIL	-0.3	--	0.8	V
	高电平输出电压	VOH	2.4	--	VDDO+0.3	V
	低电平输出电压	VOL	-0.3	--	0.4	V
1.8V IO	高电平输入电压	VIH	0.65	--	VDDO+0.3	V
	低电平输入电压	VIL	-0.3	--	0.35*VDDO	V
	高电平输出电压	VOH	1.4	--	VDDO+0.3	V
	低电平输出电压	VOL	-0.3	--	0.4	V

5. 功能定义

5.1.核心板接口定义

Pin	CORE-3506J-Y 引脚定义	引脚编号	默认功能
1	GND		GND
2	VO_LCDC_D16/DSMC_INT3/FLEXBUS1_D11/FLEXBUS0_D14/FLEXBUS1_CSN_M1/SAI2_LRCK_M1/RM_IO26/GPIO1_B3_d	B5	LCD_D16
3	VO_LCDC_D16/DSMC_INT3/FLEXBUS1_D11/FLEXBUS0_D14/FLEXBUS1_CSN_M1/SAI2_LRCK_M1/RM_IO26/GPIO1_B3_d	1A1	LCD_D15
4	VO_LCDC_D14/DSMC_D7/FLEXBUS1_D13/FLEXBUS0_D12/FLEXBUS1_CSN_M2/GPIO1_B5_d	C3	LCD_D14
5	VO_LCDC_D13/DSMC_CSN0/FLEXBUS1_D14/FLEXBUS0_D11/FLEXBUS0_CSN_M3/GPIO1_B6_d	A3	LCD_D13
6	VO_LCDC_D12/DSMC_RDYN/FLEXBUS1_D15/FLEXBUS0_D10/FLEXBUS1_CSN_M3/GPIO1_B7_d	B3	LCD_D12
7	VO_LCDC_D11/DSMC_RESETN/FLEXBUS1_CLK/DSMC_INT1/FLEXBUS0_CSN_M4/DSMC_SLV_CLK/GPIO1_C0_d	A2	LCD_D11
8	VO_LCDC_D10/DSMC_D8/FLEXBUS0_CLK/DSM_AUD_RN_M0/FLEXBUS1_CSN_M4/SAI2_MCLK_M1/DSMC_SLV_DQS0/GPIO1_C1_d	B2	LCD_D10
9	VO_LCDC_D9/DSMC_D9/FLEXBUS0_D9/DSM_AUD_RN_M0/FLEXBUS0_CSN_M5/SAI2_SDI_M1/RM_IO27/DSMC_SLV_D0/GPIO1_C2_d	B1	LCD_D9
10	VO_LCDC_D8/DSMC_D10/FLEXBUS0_D8/FLEXBUS1_CSN_M5/SAI2_SDO_M1/RM_IO28/DSMC_SLV_D1/GPIO1_C3_d	C2	LCD_D8
11	VO_LCDC_D7/DSMC_D11/FLEXBUS0_D7/DSMC_SLV_	C1	LCD_D7

	D2/GPIO1_C4_d		
12	VO_LCDC_D6/DSMC_D12/FLEXBUS0_D6/DSMC_SLV_D3/GPIO1_C5_d	D3	LCD_D6
13	VO_LCDC_D5/DSMC_D13/FLEXBUS0_D5/DSMC_SLV_D4/GPIO1_C6_d	E3	LCD_D5
14	VO_LCDC_D4/DSMC_D14/FLEXBUS0_D4/DSMC_SLV_D5/GPIO1_C7_d	E2	LCD_D4
15	VO_LCDC_D3/DSMC_D15/FLEXBUS0_D3/DSM_AUD_LN_M0/DSMC_SLV_D6/GPIO1_D0_d	E1	LCD_D3
16	VO_LCDC_D2/DSMC_DQ51/FLEXBUS0_D2/DSM_AUD_LP_M0/UART5_RTSN_M1/RM_IO29/DSMC_SLV_D7/GPIO1_D1_d	F3	LCD_D2
17	VO_LCDC_D1/DSMC_CSN2/FLEXBUS0_D1/UART5_TX_M1/RM_IO30/DSMC_SLV_CSN0/GPIO1_D2_d	F2	LCD_D1
18	VO_LCDC_D0/DSMC_CSN3/FLEXBUS0_D0/UART5_RX_M1/RM_IO31/DSMC_SLV_RDYN/GPIO1_D3_d	G3	LCD_D0
19	GND		
20	VCC_IO_1 (GPIO1 power Input,defaultNC)		NC (GPIO1 power input, defaultNC)
21	OSC_CLK_OUT/REF_CLK0_OUT/GPIO0_D0_d	G1	HP_DET, Active H
22	UART0_RX/JTAG_TMS_M1/RM_IO23/GPIO0_C7_u	J1	UART0_RX Debug
23	UART0_TX/JTAG_TCK_M1/RM_IO22/GPIO0_C6_u	J2	UART0_TX Debug
24	ETH_CLK0_25M_OUT/AUPLL_CLK_IN/RM_IO20/GPIO0_C4_d	K2	RXER/FXEN1
25	REF_CLK1_OUT/SPI0_MISO/RM_IO18/GPIO0_C2_d	L1	GPIO0_C2_dToJ6
26	ETH_CLK1_25M_OUT/SPI0_CSN0/RM_IO19/GPIO0_C3_d	L2	GPIO0_C3_dToJ6
27	SPI0_MOSI/RM_IO17/GPIO0_C1_d	M3	GPIO0_C1_d To J6
28	SPI0_CLK/RM_IO16/GPIO0_C0_d	M2	GPIO0_C0_dToJ6
29	SAI1_SDO2/SPI1_CSN0/RM_IO14/GPIO0_B6_d	N3	GPIO0_B6_d To J6/(TP_INT)
30	SAI1_SDO1/RM_IO13/GPIO0_B5_d	N1	RXER/FXEN0
31	SAI1_SDO3/SPI0_CSN1/RM_IO15/GPIO0_B7_d	N2	GPIO0_B7_d To J6
32	SAI1_SDO0/RM_IO12/GPIO0_B4_d	P3	SAI1_SDO0
33	SAI1_SDI/RM_IO11/GPIO0_B3_d	P2	SAI1_SDI
34	SAI1_LRCK/SPI1_MISO/RM_IO10/GPIO0_B2_d	R3	SAI1_LRCK
35	SAI1_SCLK/SPI1_MOSI/RM_IO9/GPIO0_B1_d	R1	SAI1_SCLK
36	SAI1_MCLK/SPI1_CLK/RM_IO8/GPIO0_B0_d	R2	SAI1_MCLK
37	VCC5V0_SYS		System Power supply INPUTInputVoltage: 5.0V,+/-5% Input current: Type 200mA ; Max 300mA
38	VCC5V1_SYS		
39	VCC5V2_SYS		
40	VCC5V3_SYS		
41	VCC5V4_SYS		

42	VCC5V5_SYS		
43	GND		GND
44	GND		
45	GND		
46	GND		
47	GND		
48	GND		
49	GND		
50	NPOR	T3	Active L
51	SAI0_SDI3/SPI1_CSN1/RM_IO7/GPIO0_A7_d	T2	RTC_INT Input,Active L
52	SAI0_SDI2/RM_IO6/GPIO0_A6_d	U3	TP_INT Iput,Active L
53	SAI0_SDI1/RM_IO5/GPIO0_A5_d	U1	I2C0_SDACore board pull up Resistor 2.2 K
54	SAI0_SDI0/RM_IO4/GPIO0_A4_d	U2	I2C0_SCLCore board pull up Resistor 2.2 K
55	GND		GND
56	SAI0_SDO/RM_IO3/GPIO0_A3_d	V2	BL_PWM
57	GND		GND
58	GND		GND
59	GND		GND
60	VCC_IO_4 (GPIO4 power Inuput,defaultNC)		NC(GPIO4 power Inu put,defaultNC)
61	VCC_1V8 (OUTPUT)		1.8V Output, Max 100mA
62	VCC_1V9 (OUTPUT)		
63	VCC_IO_3 (GPIO3 power Inuput,defaultNC)		NC (GPIO3 power in put, defaultNC)
64	VCC_3V3 (OUTPUT)		3.3V Output, MAX 500mA
65	VCC_3V4 (OUTPUT)		
66	GND		GND
67	UART5_RTSM_M0/ETH_RMII1_MDIO/GPIO3_B5_d	P21	RMII1_MDIO
68	UART5_TX_M0/ETH_RMII1_MDC/GPIO3_B4_d	P23	RMII1_MDC
69	UART5_RX_M0/ETH_RMII1_TXEN/GPIO3_B3_d	P22	RMII1_TXEN
70	UART5_CTSN_M0/ETH_RMII1_TXD1/GPIO3_B2_d	N21	RMII1_TXD1
71	SAI2_LRCK_M0/ETH_RMII1_TXD0/GPIO3_B1_d	M21	RMII1_TXD0
72	GND		GND
73	SAI2_SDO_M0/ETH_RMII1_CLK/GPIO3_B0_d	M23	RMII1_CLK
74	SAI2_MCLK_M0/ETH_RMII1_RXDVCRS/GPIO3_B6_d	R22	RMII1_RXDV_CRS
75	SAI2_SCLK_M0/ETH_RMII1_RXD1/GPIO3_A7_d	M22	RMII1_RXD1
76	SAI2_SDI_M0/ETH_RMII1_RXD0/GPIO3_A6_d	L22	RMII1_RXD0
77	GND		GND

78	ETH_RMII0_MDIO/DSM_AUD_LP_M1/SAI3_SDO/GPIO2_B7_d	G21	RMII0_MDIO
79	ETH_RMII0_MDC/DSM_AUD_LN_M1/SAI3_SDI/GPIO2_B6_d	F22	RMII0_MDIO
80	ETH_RMII0_TXEN/DSM_AUD_RP_M1/SAI3_LRCK/GPIO2_B5_d	F23	RMII0_MDIO
81	ETH_RMII0_TXD1/DSM_AUD_RN_M1/SAI3_SCLK/GPIO2_B4_d	F21	RMII0_TXD1
82	ETH_RMII0_TXD0/SPI2_MISO/GPIO2_B3_d	E22	RMII0_TXD0
83	GND		GND
84	ETH_RMII0_CLK/SPI2_MOSI/GPIO2_B2_d	E21	RMII0_CLK
85	ETH_RMII0_RXDVCRS/SAI3_MCLK/GPIO2_C0_d	G22	RMII0_RXDV_CRS
86	ETH_RMII0_RXD1/SPI2_CSN/GPIO2_B1_d	D23	RMII0_RXD1
87	ETH_RMII0_RXD0/SPI2_CLK/GPIO2_B0_d	D21	RMII0_RXD0
88	GND		GND
89	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN/GPO4_A4_z	B14	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN
90	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP/GPO4_A5_z	B13	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP
91	GND		GND
92	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N/GPO4_A2_z	B12	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N
93	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P/GPO4_A3_z	A12	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P
94	GND		GND
95	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N/GPO4_A0_z	A11	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N
96	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P/GPO4_A1_z	B11	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P
97	GND		GND
98	SARADC_IN3/GPIO4_B3_z (OTP)	B21	ADC3 input
99	SARADC_IN2/GPIO4_B2_z (OTP)	A21	ADC2 input
100	SARADC_IN1/GPIO4_B1_z (RECOVER) (OTP)	B20	ADC1 input (RECOVERY_Key) ,
101	SARADC_IN0/GPIO4_B0_z (BOOT) (OTP)	A20	ADC0 input (BOOT_Key)
102	GND		GND
103	ACODEC_ADC_INP		ACODEC_IN+ input
104	ACODEC_ADC_INN		ACODEC_IN-input,
105	SDMMC_D1/TEST_CLK_OUT/GPIO3_A3_d (mount EMMC,thispin NC)	K22	NC
106	SDMMC_D0/GPIO3_A2_d (mount EMMC,thispin NC)	K23	NC
107	GND		GND

108	SDMMC_CLK/GPIO3_A0_d (mount EMMC,thispin NC)	K21	NC
109	GND		GND
110	SDMMC_CMD/GPIO3_A1_d (mount EMMC,thispin NC)	J21	NC
111	SDMMC_D3/JTAG_TMS_M0/GPIO3_A5_d (mount EMMC,thispin NC)	H22	NC
112	SDMMC_D2/JTAG_TCK_M0/GPIO3_A4_d (mount EMMC,thispin NC)	H23	NC
113	SAI0_LRCK/RM_IO0/GPIO0_A0_u	V3	SDMMC_POWER_EN Output, Active H
114	SAI0_MCLK/RM_IO2/GPIO0_A2_u	W2	SDMMC_DET Input, Active L
115	USB20_OTG0_VBUSDET (For USB update)	B18	Active H
116	USB20_OTG0_ID	B17	USB_OTG_ID,Active L
117	GND		GND
118	USB20_OTG0_DM (For USB update)	B16	USB20_OTG0_DM
119	USB20_OTG0_DP (For USB update)	A16	USB20_OTG0_DP
120	GND		GND
121	USB20_OTG1_DM	B15	USB20_OTG1_DM
122	USB20_OTG1_DP	A15	USB20_OTG1_DP
123	GND		GND
124	VO_LCDC_DEN/DSMC_CLKP/FLEXBUS1_D0/GPIO1_A0_d	B10	LCDC_DEN
125	VO_LCDC_VSYNC/DSMC_CLKN/FLEXBUS1_D1/DSMC_INT0/DSMC_SLV_INT/GPIO1_A1_d	1A5	LCDC_VSYNC
126	VO_LCDC_HSYNC/DSMC_DQS0/FLEXBUS1_D2/GPIO1_A2_d	A9	LCDC_HSYNC
127	GND		GND
128	VO_LCDC_CLK/DSMC_D0/FLEXBUS1_D3/GPIO1_A3_d	B9	CDC_CLK
129	GND		GND
130	VO_LCDC_D23/DSMC_D1/FLEXBUS1_D4/GPIO1_A4_d	B8	LCD_D23
131	VO_LCDC_D22/DSMC_D2/FLEXBUS1_D5/GPIO1_A5_d	1A4	LCD_D22
132	VO_LCDC_D21/DSMC_D3/FLEXBUS1_D6/GPIO1_A6_d	A7	LCD_D21
133	VO_LCDC_D20/DSMC_D4/FLEXBUS1_D7/GPIO1_A7_d	B7	LCD_D20
134	VO_LCDC_D19/DSMC_D5/FLEXBUS1_D8/FLEXBUS0_CSN_M0/GPIO1_B0_d	1A3	LCD_D19
135	VO_LCDC_D18/DSMC_CSN1/FLEXBUS1_D9/FLEXBUS1_CSN_M0/UART5_CTSN_M1/RM_IO24/GPIO1_B1_d	1A2	LCD_D18
136	VO_LCDC_D17/DSMC_INT2/FLEXBUS1_D10/FLEXBUS0_D15/FLEXBUS0_CSN_M1/SAI2_SCLK_M1/RM_IO25/GPIO1_B2_d	A5	LCD_D17

5.2.引脚复用

RK3506B 支持 RM_IO (Rockchip Matrix IO) 它让众多功能信号共享有限的引脚接口, 在同一个矩阵中, 任何功能信号都可以通过软件配置映射任何引脚接口。RM_IO 支持 98 个功能信号映射到 32 个引脚接 (GPIO0_A0~GPIO0_C7, GPIO1_B1~GPIO1_B3, GPIO1_C2~GPIO1_C3, GPIO1_D1~GPIO1_D3), 下面是矩阵 IO 功能。

Function Index	RM_IO	function index	RM_IO
1	UART1_TX	50	TOUCH_KEY_IN7
2	UART1_RX	51	SAI0_MCLK
3	UART2_TX	52	SAI0_SCLK
4	UART2_RX	53	SAI0_LRCK
5	UART3_TX	54	SAI0_SDI0
6	UART3_RX	55	SAI0_SDI1
7	UART3_CRSN	56	SAI0_SDI2
8	UART3_RTSN	57	SAI0_SDI3
9	UART4_TX	58	SAI0_SDO
10	UART4_RX	59	SAI1_MCLK
11	UART4_CRSN	60	SAI1_SCLK
12	UART4_RTSN	61	SAI1_LRCK
13	MIPI_DPHY_DSI_TX_T E	62	SAI1_SDI0
14	CLK_32K	63	SAI1_SDI1
15	I2C0_SCL	64	SAI1_SDI2
16	I2C0_SDA	65	SAI1_SDI3
17	I2C1_SCL	66	SAI1_SDO
18	I2C1_SDA	67	SPI0_CLK
19	I2C2_SCL	68	SPI0_MOSI
20	I2C2_SDA	69	SPI0_MISO
21	PDM_CLK0	70	SPI0_CSN0
22	PDM_SDI0	71	SPI0_CSN1
23	PDM_SDI1	72	SPI1_CLK
24	PDM_SDI2	73	SPI1_MOSI
25	PDM_SDI3	74	SPI1_MISO
26	CAN1_TX	75	SPI1_CSN0
27	CAN1_RX	76	SPI1_CSN0
28	CAN0_TX	77	TSADC_CTRL
29	CAN0_RX	78	PMU_SLEEP
30	PWM0_CH0	79	CORE_POWER_OFF
31	PWM0_CH1	80	SPDIF_TX
32	PWM0_CH2	81	SPDIF_RX
33	PWM0_CH3	82	PWM1_BIP_CNTR_A0
34	PWM1_CH0	83	PWM1_BIP_CNTR_A1
35	PWM1_CH1	84	PWM1_BIP_CNTR_A2
36	PWM1_CH2	85	PWM1_BIP_CNTR_A3

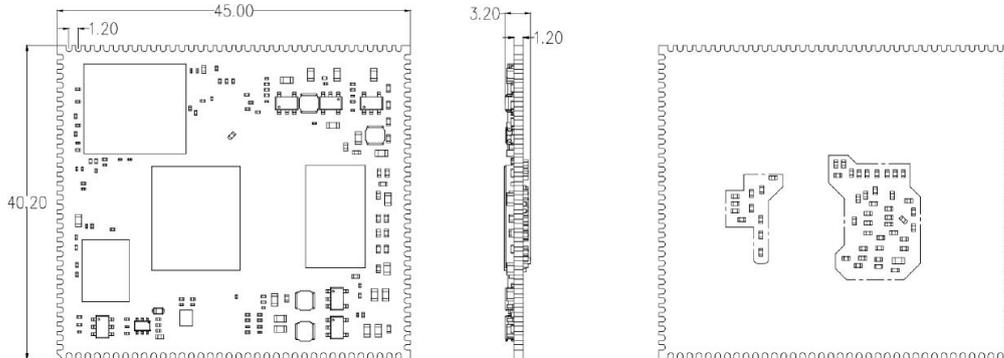
37	PWM1_CH3	86	PWM1_BIP_CNTR_A4
38	PWM1_CH4	87	PWM1_BIP_CNTR_A5
39	PWM1_CH5	88	PWM1_BIP_CNTR_B0
40	PWM1_CH6	89	PWM1_BIP_CNTR_B1
41	PWM1_CH7	90	PWM1_BIP_CNTR_B2
42	TOUCH_KEY_DRIVE	91	PWM1_BIP_CNTR_B3
43	TOUCH_KEY_IN0	92	PWM1_BIP_CNTR_B4
44	TOUCH_KEY_IN1	93	PWM1_BIP_CNTR_B5
45	TOUCH_KEY_IN2	94	PDM_CLK1
46	TOUCH_KEY_IN3	95	ETH_RMIO_PPCLK
47	TOUCH_KEY_IN4	96	ETH_RMIO_PPSTRIG
48	TOUCH_KEY_IN5	97	ETH_RMIO_PPCLK
49	TOUCH_KEY_IN6	98	ETH_RMIO_PPSTRIG

6. 机械尺寸

6.1. 核心板机械尺寸

Core-RK3506 核心板的尺寸图如图 6.1 所示，单位（mm）。

核心板尺寸	45.0mm*40.2mm
层数	6
接口类型	邮票孔接口



6.2. 核心板邮票孔接口封装

具体参考飞书资料包，硬件设计资料-数据手册-连接器数据手册目录，可以联系我司获取。

7. 技术支持

7.1. 基础技术支持

1. 获取本公司产品的软、硬件开发资料
2. 使用本公司产品过程中遇到的问题
3. 协助搭建编译环境与编译执行提供的源代码
4. 本公司产品的故障判断及售后维修服务
5. ODM项目方案实现及其售后技术支持

7.2. 增值技术支持

1. BSP包及相关驱动代码的分析说明
2. 用户应用程序开发的软硬件问题
3. 用户自行裁减、编译运行嵌入式操作系统遇到的问题
4. 用户对操作系统或驱动进行移植遇到的问题

7.3. 技术支持联系方式

1. 技术热线：020-32167606
2. 技术邮箱：support@talowe.com
3. 工作时间：8：30-12：00、13：30-18：00
4. 周一至周五（节假日除外）
5. 邮件时间：在技术支持范围的问题收到后，24小时内给予回复

7.4. 定制服务

提供嵌入式操作系统底层驱动、ARM 核心板、底板等硬件板卡的有偿定制开发服务，以尽快的缩短您的产品开发周期。

8. 售后服务

8.1. 保修条例

本公司自产品出售之日起，提供终身的产品维护服务，对于在保修期内的故障产品和超过保修期限的产品，我们提供有偿维修服务，在客户确认接受产品的维修费用后，安排进行产品的维护。

8.2. 维修周期

1. 常规故障维修周期为7个工作日（不含运输时间）；
2. 特殊故障另行确认维修周期。

8.3. 维修费用

1. 在保修期内的产品，产品自身问题，我司无偿进行维修；
2. 由于客户使用不当造成产品损坏，不符合保修条件的维修产品，在可以修复的情况下，只收取原件材料费，不收取维修服务费用；
3. 超过保修期限的维修产品，根据实际的损坏程度确定收取原件材料费和维修服务费。

8.4. 运输费用

1. 属于保修期内产品的正常问题，返修产品运输费用由客户承担，返还的运输费用由我司承担；
2. 属于人为损坏的产品，来回运费均由客户承担。

8.5. 送修地址

地 址：广州市黄浦区东明三路 18 号智造谷创新园 D 栋 903 室生产部

联系人：生产部

电 话：020-3216 7606

邮 编：511300

须知：请注意快递运输暴力；要妥善包装，建议使用顺丰或京东；如无特殊情况，不接收任何到付件。